

計測技術受託サービス

Electronics Assembly and Interconnect Engineering Service

特長 Features

- プリント配線板の設計・製造・実装で培った技術でお客様の原理検証・先行開発をサポートします
To Support Customer's POC Development with Meiko's Technology Experienced in PCB's design, manufacturing and Assembly
- 100GHz帯までの材料誘電特性と伝送線路の計測、電磁界解析、測定基板製造を提供します
Measurement of Material Dk/Df & PCB S-Parameter, Electromagnetic field simulation, Test Vehicle design & it's Manufacturing

お客様 Customer	ご支援内容 Offering Services	設計 解析 Design Simulation	基板 製造 PCB Fabrication	部品 実装 Device Ass'y	誘電 特性 Dk/Df Measure	伝送路 測定 S-para Measure	加工 条件 Process Condition	基板 分析 PCB Analysis	信頼性 試験 Reliability Test	特性 評価 Performance Evaluation
材料メーカー Material Supplier	比誘電率・誘電正接 測定 Dielectric Properties Measurement				×					
	材料加工性 評価 Material Manufacturability Evaluation		×				×	×	×	
	材料開発支援 Material Development Support	×	×	×	×	×	×	×	×	×
基板メーカー Competitor	基板伝送特性 評価 PCB High-Speed Line Measurement	×				×				
セットメーカー OEM Supplier	高速デジタル基板 材料選定 Material Choice for High-Speed PCB	×	×		×	×		×		
	高速デジタル基板 開発支援 High-Speed PCB Development	×	×	×		×		×		
	モジュール実装基板 製造 Module PCB Assembly Manufacturing	×	×	×						
	部品内蔵基板 製造開発 Embedded Device PCB Manufacturing	×	×	×				×	×	×

設計／解析 Design / Simulation			誘電特性測定 Dk/Df Measure	伝送路測定 S-parameter Measure
伝送線路Sパラ解析 High Speed Line S-Parameter	伝熱解析 Heat Dissipation	熱応力連成解析 Thermal Stress	平衡型円板共振器 BCDR	セミオートプローパー Semi-Auto Probe Station

基板製造 PCB Manufacturing			加工条件 Process Condition	基板分析 PCB Analysis
高周波材料基板 High-Speed Material PCB	めっき接続部品内蔵基板 Laser-Attachment Embedding PCB	はんだ接続部品内蔵基板 Solder-Attachment Embedding PCB	ビア形成 Via Formation	FT-IR分析 FT-IR Analysis EDX元素分析 EDX Analysis X線分析 X-ray 断面解析 X-section Analysis

信頼性試験 Reliability Test	特性評価 Performance Evaluation			
冷熱衝撃 TCT イオンマイグレーション THB	アイダイアグラム Eye-Diagram	電源インピーダンス GND-Impedance	パワー素子内蔵 放熱 Power-IC Heat Dissipation	FET銅インレイ 放熱 Cu-Inlay Heat Dissipation